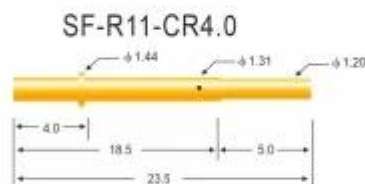
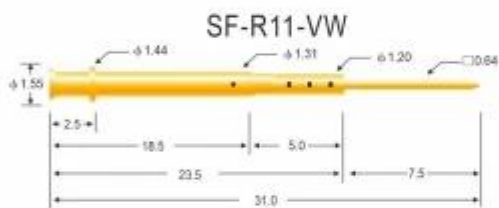
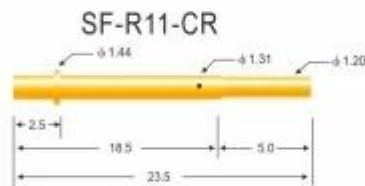
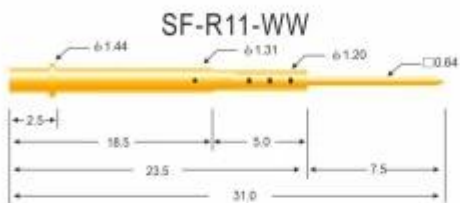
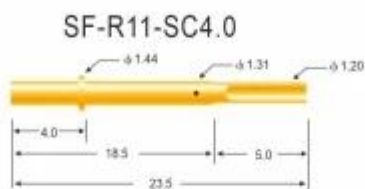
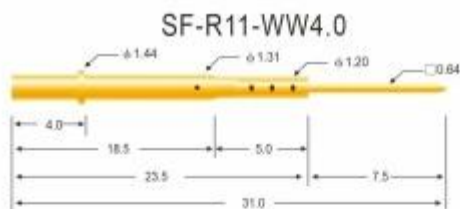
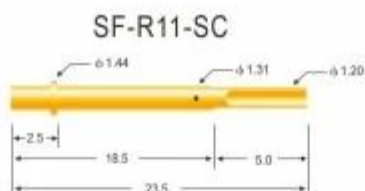


SFENG 1984 ()



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Materials and finishes 材料及涂饰	Barrel: Brass, Au plated
Connections 接线形式	Crimp: R11-VCR, R11-CR, R11-CR4.0 Solder cup: R11-VSC, R11-SC, R11-SC4.0 Wire wrap: R11-VW, R11-WW, R11-WW4.0

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

厚度	1.0mm±.0394"
厚度	0.75mm±.0295"
厚度	2.0±.0787"
厚度	80
厚度	SK4 厚度 厚度
厚度	1A
厚度	50
厚度	100
厚度	厚度7

厚度

- 1.厚度24
- 2.厚度OEM
- 3. 厚度
- 4.厚度

厚度

- 1.厚度PCB ICT FCT
- 2.Pogo pin
- 3. BGA
- 4.厚度QZ VZ LM
- 5.厚度
- 6.厚度/
- 7.厚度30#OK POM

厚度

厚度



□□□□



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



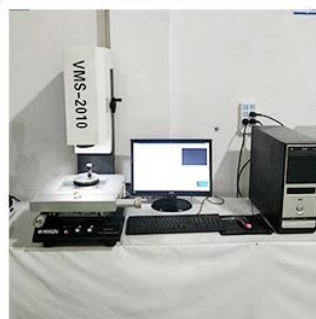
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 請說明

A1: 請說明

Q2. 請說明

A2: 請說明QC

Q3. 請說明

A3: 請說明

Q4. 請說明

A4: 請說明

Q5. 請說明

A5 請說明m

Q6. 請說明

A6: 請說明

Q7. 請說明 OEM 與 ODM 的

A7: 請說明 OEM /ODM . P

Q8. 請說明

A8: 請說明

請說明

請說明 DHL、UPS、FedEx、TNT、EMS

請說明 Exwork、FOB、CNF、CIF



0000



2023 ISO Certificate



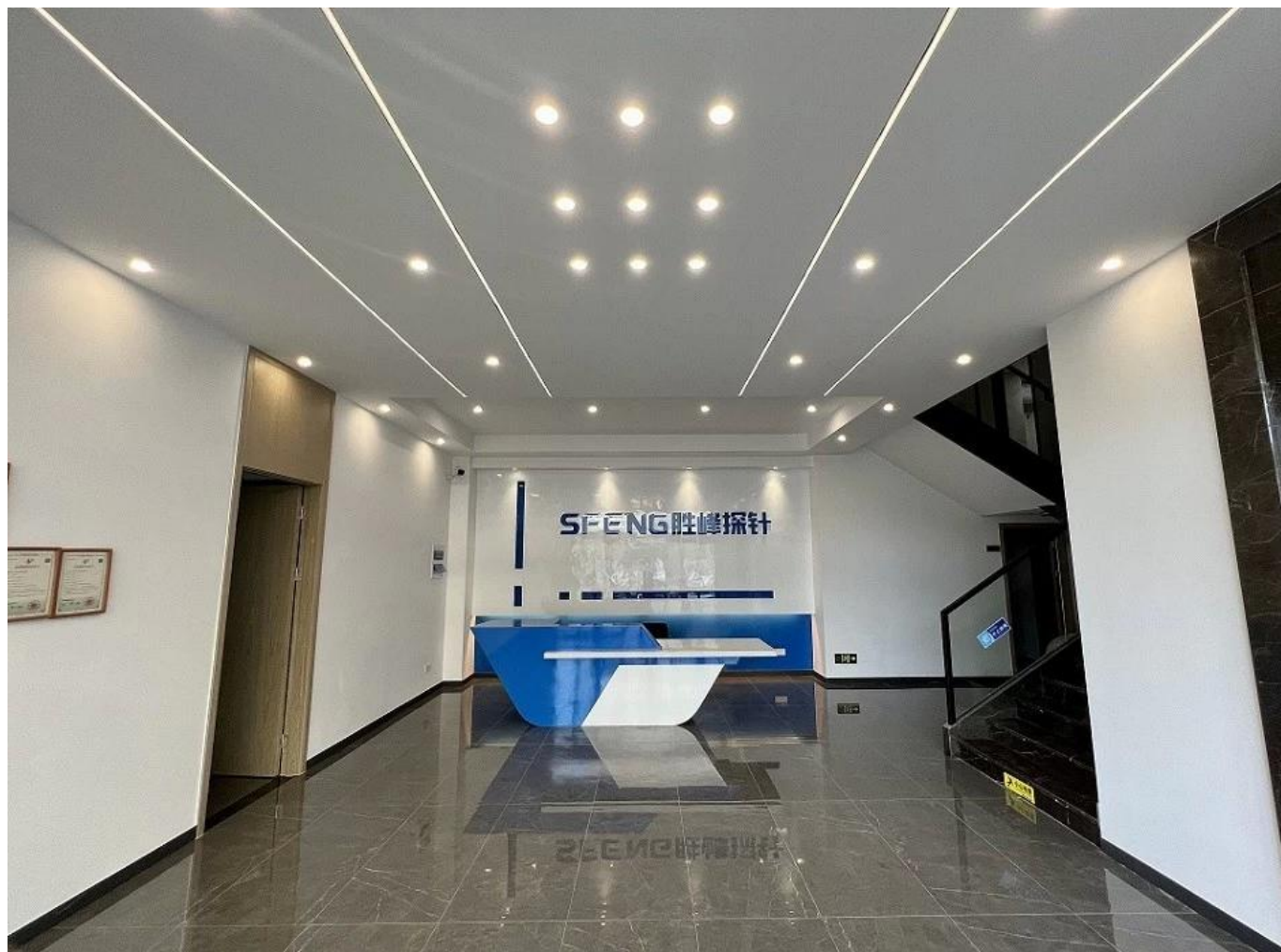
Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe

0000







000000



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

